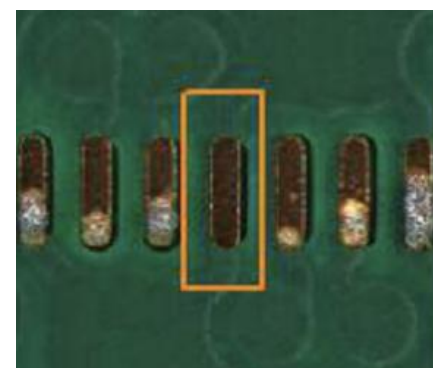
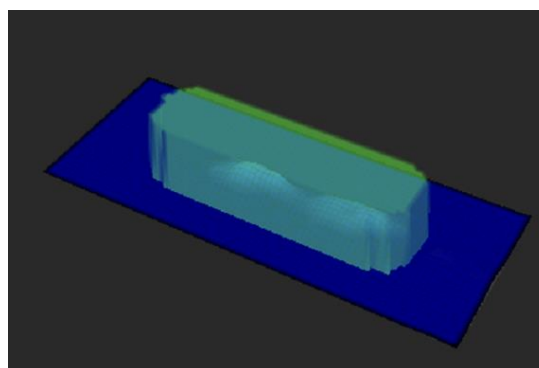


V moderných technológiách povrchovej montáže SMT (Surface Mount Technology), kvalita čistenia stencilu, cez ktorý sa spájkovacia pasta tlačí na dosku plošných spojov, priamo ovplyvňuje presnosť a spoľahlivosť procesu. Má vplyv aj na plynulosť výroby vďaka minimalizácii nevyhnutných prerušení výrobných linky.

V rámci tohto projektu sme sa zaoberali analýzou kvality a výkonnosti štyroch typov čistiacich roliek, ktoré má k dispozícii spoločnosť Magna.

Pri finálnom výbere typu rolky by sme upriamili dôraz taktiež na cenu týchto produktov, prípadne na dĺžku navinutého čistiaceho materiálu na jadre.

- Otestovanie parametrov roliek praktickými experimentami.
- Nastavenie programu pre dávkovanie čistiaceho roztoku.
- Analýza údajov vyplývajúcich z SPI (Solder Paste Inspection).



- Vyhodnotenie, či príčinou defektov vo výrobe bolo nevhodné čistenie stencilu.
- Výber typov najvhodnejších roliek, pri ktorých bolo zaznamenaných najmenej chýb počas výroby a po prestojoch.

Typ rolky	Počet vyrobených ks DPS	Počet prestojov	Počet prestojov spôsobujúcich chybu	Percentuálny podiel prestojov spôsobujúcich chybu	Úspešnosť bez prestojov
MP Scanditron HCESII45017	2313	21	5	23,81 %	99,05 %
AMTEST 650-450-17-T	2560	13	2	15,38 %	99,37 %
CSHP006 DEK/450/650P/17M	1214	14	2	14,29 %	99,26 %
EKRA 8017000268 450mm / 17m Puro	2119	13	7	53,85 %	99,15 %